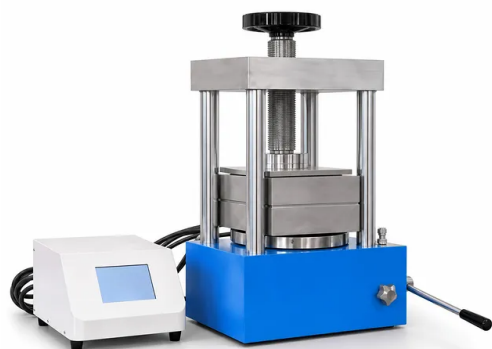


Pressa Per Riscaldamento Integrata Da 24 Ton 200X200Mm Per La Preparazione Di Campioni Di Laboratorio

Numero articolo: XP55



introduzione

Pressa per riscaldamento integrata professionale con forza di serraggio di 24 tonnellate e piastre riscaldate da 200x200mm, ideale per la ricerca sulle batterie, le prove dei materiali e la preparazione di campioni. Il controllo preciso della temperatura fino a 300°C garantisce risultati affidabili e coerenti.

Ulteriori informazioni

Applicazione	Descrizione	Vantaggio Chiave
Pressatura Elettrodi ed Elettroliti per Batterie	Consolidazione di polveri di catodo/anodo e formazione di pastiglie di elettrolita allo stato solido per batterie agli ioni di litio e celle di nuova generazione.	Una distribuzione uniforme della densità previene i punti caldi e garantisce una conducibilità ionica coerente in tutta la pastiglia.
Goffratura e Laminazione di Film Polimerici	Incollaggio termico di film polimerici multistrato, sigillatura di chip microfluidici e texturizzazione superficiale per dispositivi lab-on-a-chip.	Il controllo preciso di temperatura e pressione preserva le nanostrutture delicate senza degrado termico.
Preparazione Pastiglie per FTIR e XRF	Produzione di pastiglie di KBr trasparenti per spettroscopia infrarossa e perline fuse per analisi di fluorescenza a raggi X.	Elimina le inclusioni d'aria e le variazioni di spessore, garantendo linee base spettrali riproducibili.
Sviluppo di Materiali Compositi	Pressatura a caldo di compositi a matrice metallica, polimeri rinforzati con ceramica e consolidazione di pre-impregnati in fibra di carbonio.	Massimizza la bagnatura delle fibre e l'eliminazione dei vuoti sotto profili controllati di calore e pressione.
Produzione Pilota di Compresse Farmaceutiche	Compressione in piccoli lotti di miscele di polveri in compresse per prove di formulazione e studi di stabilità.	La registrazione completa dei parametri di pressatura agevola la documentazione FDA/EMA e gli studi di scalabilità.
Sinterizzazione in Metallurgia delle Polveri	Pre-compattazione di polveri metalliche e ceramiche a temperature elevate prima della sinterizzazione finale.	Aumenta la densità verde e riduce il ritiro di sinterizzazione, migliorando la precisione della forma netta.
Incollaggio Wafer per Semiconduttori	Incollaggio per compressione termica di wafer di silicio o assemblaggi chip-on-flex utilizzando forza e temperatura controllate.	Raggiunge linee di incollaggio uniformi senza vuoti, un elemento critico per la fabbricazione di sistemi microelettronici (MEMS).

Parametro	XP55
Modello	XP55
Capacità della Pressa	0 - 24 tonnellate
Temperatura di Lavoro delle Piastre	Ambiente - 300 °C
Potenza di Riscaldamento (Totale)	1200 W (2 × 600 W)
Dimensioni delle Piastre	200 × 200 mm
Raffreddamento delle Piastre	Circolazione d'acqua integrata
Controllo della Temperatura	PID a doppia zona con stabilità ±2 °C
Display e Controllo	Touchscreen da 4,3 pollici, programmabile
Alimentazione	220 V, 50 Hz, monofase
Dimensioni Complessive (L × P × H)	950 × 260 × 525 mm
Peso Netto	180 kg